

证券代码： 300782

证券简称：卓胜微

### 2019年7月25日投资者关系活动记录表

编号：2019-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参会人员：（以下排名不分先后） 毕盛资产、安芯投资、安信证券、安信基金、宝盈基金、彬元资本、博时基金、财通证券、财通资管、财通基金、杭州德亚、上海顶天、东北证券、东方证券、东海基金、东海证券、东兴证券、敦和资产、方正证券、伏明资产、富国基金、观富资产、光大保德信基金、光大证券、广发证券、广州金控资产、国海证券、国华人寿、国金证券、国联证券、国联安基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安证券、国元证券、海富通基金、海通证券、河清资本、恒越基金、红骉投资、红塔证券、宏道投资、泓澄投资、鸿凯投资、华创证券、华润元大基金、华泰柏瑞、华泰保险、华泰证券、汇丰晋信基金、汇丰前海证券、汇鸿国际、汇鑫投资、嘉合基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德基金、金鹰基金、景泰利丰、凯丰投资、凯基证券、凯石基金、民生加银基金、民生证券、摩根华鑫基金、南方基金、农银汇理基金、诺德基金、盘京投资、磐厚资本、平安基金、平安养老、平安资产、浦银安盛基金、千合资本、瑞信方正证券、睿柏资本、上海博颐、上海慈阳、上海汐泰、上海证券、上投摩根基金、尚雅投资、申万菱信基金、申银万国证券、施罗德、太平基金、太平洋证券、太平资产、泰达宏利基金、泰康资产、泰信基金、弢盛资产、天虫资本、天风证券、万家基金、西安玖润投资、新华资产、新华基金、新时代证券、兴全基金、兴业基金、兴业证券、寻常投资、弈慧投资、银河基金、银华基金、永赢基金、煜德投资、元大证券、源乐晟资产、

	<p>长安基金、长江证券、长信基金、招商证券、浙商基金、浙商证券、正心谷创新资本、中大君悦、中国人寿、中海基金、中欧基金、中融基金、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中银基金、重阳投资、华安基金、鸿德基金、东方点石、彤源投资、兴证证券、苏州三叶树、天弘基金、上海敦颐资产、庐雍资产、南土资产、兴银基金、德邦基金、德邦证券、广证恒生、中金公司、亘曦资产、翊安投资、工银国际证券、金翼基金、华夏顺泽、盈峰资本、旌乾资产、弘毅远方基金、域秀资本、万联证券、UG INVESTMENT ADVISERS LTD、小郁资产、圆信永丰基金、前海汇杰达理、国投瑞银、信达澳银基金、上海聚鸣、上海理成、上海晟盟、天治基金、杉石资产、北大方正人寿、中富投资、平安证券、鹏扬基金、金恒宇投资、华夏久盈、长江创新投资、鸿道投资</p>
时间	2019年7月25日
地点	无锡市滨湖区建筑西路777号瑞廷西郊酒店
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：许志翰</p> <p>副总经理、董事会秘书：FENG CHENHUI（冯晨晖）</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者活动的主要内容如下：</p> <p>一、公司董事长、总经理许志翰，副总经理、董事会秘书 FENG CHENHUI（冯晨晖）向与会人员介绍公司概况，包括公司创始人团队、创业历程、战略目标、竞争优势、产品介绍等；</p> <p>二、在沟通交流环节，主要回复如下：</p> <p><b>1、公司目前在滤波器领域的进展以及客户导入情况，公司是如何实现在 SAW 滤波器产品上突破的？</b></p> <p>答：公司已推出滤波器产品，将根据募投项目建设周期及规划推进滤波器产品及产业化建设。公司通过自主研发创新，完成了在滤波器产品线的突破。公司的目标是做差异化的芯片，做出卓胜微自有的特色。公司非常关注知识产权的完整性，滤波器方面，BAW 和 FBAR 专利壁垒较强，而 SAW 实现门槛相对较低，因此公司选择以 SAW 作为突破口。公司综合实力与行业头部国际领先企业相比仍有较大差距，公司需要不断努力持续进步，借助资本市场加快前进步伐。</p> <p><b>2、SAW 公司团队组成？面对 5G 与 BAW 的竞争怎么看？对于 SAW 滤波器是否会自建产线？</b></p> <p>答：在 SAW 滤波器领域，公司已建立了相对完整的 SAW 滤波器研发设计团</p>

队，团队成员具有多年滤波器设计经验。随着 5G 来临，大部分移动智能终端还需要支持全模式全频段，另外基于不同的性能成本及应用要求，器件的选择上也会有不同的考虑，SAW 和 BAW 产品可能在相当长时间共存。

滤波器生产方面，公司仍然以 fabless 模式经营，由公司负责产品的设计研发和销售，通过代工厂完成晶圆及封测生产。

**3、如何看射频模组化的趋势，越来越多的射频元件被整合到模组中，射频开关、LNA 会被整合到模组中吗？**

答：随着射频前端越来越复杂，模组化趋势明显，但分立器件和模块会长时间共存。模块的形态非常多，公司会根据规划做好技术储备，全面满足客户需求。

**4、公司上半年业绩高增长的驱动因素有哪些？客户未来半年的出货预估情况如何？**

答：公司上半年业绩增长驱动主要来自于三方面，一是原有客户的进一步渗透；二是新客户合作推进；三是新产品的推广。一般而言手机通讯产业第三季度为出货量高峰，未来大趋势向好，但受国际形势不断变化的影响，客户的需求仍有很大的不确定性。

**5、产品的技术通用性如何？**

答：射频前端技术具有较强的通用性，但具体的产品需求根据客户的设计风格及性能要求等有所不同。

**6、公司目前的产品有哪些？产品策略是什么？**

答：公司目前有两大产品类型，一为射频前端产品；二为物联网产品；公司的产品策略主要是在服务好客户的基础上，不断拓展并丰富产品线。

**7、5G 对手机射频前端会有哪些影响，具体到公司产品上，5G 将带来哪些变化以及公司 5G 产品的进展？**

答：5G 通信制式会带来手机频段和新制式的增加，同时随着智能手机市场的不断成熟，高端应用不断推陈出新，对手机射频前端芯片的需求将会增加。但不同频段的设计需求、材料工艺会有一定差异。伴随 5G 的起量，天线的需求将会增加，从而需要更多的天线开关，同时载波聚合的大量应用将会大幅提升设计复杂度。

**8、公司三位创始人如何进行工作分工？**

答：公司三位创始人是 20 多年的朋友，也是 10 多年的创业合作伙伴。其中：

许志翰为公司 CEO，主要负责财务、人事行政、销售等；

FENG CHENHUI（冯晨晖）为公司 COO，主要负责公司整体运营和投资者关系管理等；

TANG ZHUANG（唐壮）为公司 CTO，主要负责公司的技术研发。

**9、PA 的进展，是否考虑通过并购完善射频领域布局？**

答：公司将根据募投项目建设周期及规划推进 PA 产品及产业化建设。公司目前没有并购计划，未来不排除通过资本运作的方式进一步加快公司战略布局。

**10、公司的竞争优势是什么？**

答：公司竞争优势主要体现在快速高效的研发创新能力、供应链管理优势、经验丰富的研发管理团队、成本优势、完善的品质管理体系、国内外知名移动终端客户资源。

创新能力方面：公司具有较强的创新能力，发明了拼版式集成射频开关方法，率先基于 RF CMOS 工艺实现射频低噪声放大器产品，是国际上先行推出集成射频低噪声放大器和开关的单芯片产品企业之一。公司以技术为导向，努力做好产品是公司永恒的目标。

供应链方面：公司认为品牌客户除了产品性能，品质和供货能力也是其关注重点。公司有较多长期的供应链合作伙伴，公司一直在用心培养和供应链的合作伙伴关系。

**12、射频开关/低噪放的单价每年降价的原因以及未来价格趋势变化？**

答：射频开关、射频低噪声放大器产品平均单价下降主要包括二个方面原因，一方面，通常情况下，一款新的芯片产品推出时，率先推出该产品的厂家在市场上有较高的定价权，随着同类产品被陆续推向市场，激烈的市场竞争导致产品价格下降，产品一旦面临更新换代，价格下降的速度将更为明显；另一方面，由于下游客户需求的变化以及新产品的推出，产品销售结构发生变化。以上两种因素综合导致公司两大产品线平均单价水平的变动。针对上述行业特征，公司一方面不断加强研发能力，通过不断推出新产品维持相对较高的利润水平，另一方面不断完善自身的质量管理体系，凭借性能良好、稳定性高的产品开拓市场，满足优质客户对产品的需求，以持续提高营业收入。

**13、公司现有的物联网产品以及产品规划介绍？**

答：物联网产品方面公司有低功耗蓝牙微控制器芯片产品，公司将在此产品基础上进行产品性能升级及新产品研发，满足多个物联网技术应用领域的定制化需求。物联网是基于无线传输，公司 BLE 产品具有一定优势。公司现有客户群中部分也在物联网领域有所投入，目标客户群体的重叠，有利于公司物联网产品的业务拓展。

**14、公司新产品什么时候可以给公司带来业绩驱动？**

答：新产品对公司的业绩产生贡献需要较长的周期，公司将持续拓展产品，

给公司提供滚动的成长空间。手机市场需求不断变化，也给了公司很好的切入机会。

**15、公司下游主要客户的需求与公司产品的供应能力的匹配程度如何？**

**答：**公司作为芯片设计厂商不直接参与晶圆生产、封测等芯片生产制造过程，为了保证产品的良率与供货能力，公司与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商形成紧密合作。公司在历史经营过程中，与知名晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，对产能供应链管理积累了较多经验；同时，由于公司销量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商重要客户，有效地稳定了公司的产能供给，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。

**16、产品迭代周期？**

**答：**公司目前射频开关和射频低噪声放大器产品的生命周期平均在 1-3 年左右。

**17、下游客户提前多久下订单，上游供应商的供货时间多久？**

**答：**通常而言，公司客户会提供 3-6 个月的采购预估，以及更长时间的趋势性预测。不同产品的供应周期不尽相同，晶圆 1-4 个月甚至更久，封测为 2 周至 1 个多月的时间。

**18、公司研发人数只有 70 人，为什么需要那么多的研发中心？**

**答：**人才是设计公司的核心资产之一，公司通过在各地设置研发基地吸纳各地人才，以实现核心技术的开发积累和人才队伍的建设。

**19、目前市场上射频前端芯片的主流工艺是什么？不同射频芯片需要不同的材料，公司如何应对？**

**答：**目前市面上主流工艺，射频开关主要是 RF SOI 工艺，低噪声放大器主要是 RF CMOS 和 SiGe 工艺；射频前端不同种类芯片的生产工艺材料不同，但是基本的技术及设计理念可以相互借鉴。

**20、拼版式射频开关、RF CMOS 工艺的 LNA，这两项技术有什么样的优越性？**

**答：**公司坚持“以技术创新为动力，以满足客户需求为目标”的宗旨，致力于建设射频领域全球领先的技术平台，公司有一定数量的发明专利和实用新型专利，通过持续推出新技术保证竞争优势，招股书所列出的两项为公司具代表性的创新实例。

过去在智能机尚未兴起时，市场上一般使用 GaAs 或 SiGe 工艺设计 LNA 产

	<p>品，主要应用于手机电视，由于手机电视的 GPS 信号较弱，因此需要 LNA 进行放大信号处理。智能手机市场爆发后，对 LNA 的需求量急剧增加，而 GaAs 或 SiGe 工艺因产能受限，供给出现短缺。公司基于前期产品的经验积累，推出了 RF CMOS 工艺的 LNA，解决了客户的供给问题。</p> <p>射频开关包括单刀双掷，单刀三掷等多种产品形态，但是公司通过研究发现可以通过共用底层模具，改动上层的方式实现器件功能的改变。基于此种技术，由于使用可共用的底层模具，公司可提前进行大规模生产备货，进而将供货周期大幅缩短，显著降低研发成本，同时提高产品的研发效率和生产效率。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2019 年 7 月 25 日